

	УТВ	ЕРЖДАЮ
Замести	гель ген	нерального директора –
диро	ектор по	о научной работе
		С.В. Щербаков
		• •
<b>«</b>	»	2022 г.

## ПРОГРАММА ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ по специальной дисциплине

Уровень высшего образования

Подготовка кадров высшей квалификации

Научная специальность

2.2.1. Вакуумная и плазменная электроника

#### 1. Форма проведения и структура вступительного испытания

Форма проведения испытания: устная. Язык – русский. Вступительное испытание проводится по билетам.

- 1-й и 2-й вопросы билета вопросы, оценивающие подготовку по теоретическим основам вакуумной и плазменной электроники;
- 3-й вопрос билета собеседование по предполагаемой теме диссертационного исследования.

Время подготовки к устному ответу – до 45 минут. Вступительное испытание оформляется протоколом, в котором фиксируются вопросы к поступающему.

# **2.** Перечень вопросов, оценивающих подготовку по теоретическим основам вакуумной и плазменной электроники (1-й и 2-й вопросы билета)

#### Физические основы вакуумной и плазменной электроники

Кинетическая теория газов. Закон идеального газа. Число Авогадро. Скорость молекул. Закон распределения Максвелла-Больцмана. Свободный пробег молекул.

Электрические явления в разреженных газах. Ионизация, возбуждение и рекомбинация газовых частиц. Эффективные сечения процессов. Движение заряженных частиц в газе.

Газовый разряд. Классификация типов газового разряда и отдельных его областей. Условия развития разряда. Кривые Пашена. Высокочастотный разряд. Явления в вакуумных и плазменных приборах.

Эмиссионная электроника. Термоэлектронная эмиссия. Распределение термоэлектронов по скоростям. Вторичная, фотоэлектронная, автоэлектронная и экзоэлектронная эмиссии.

Катоды: термоэлектронные, автоэлектронные (полевые), фотоэлектронные, вторично-эмиссионные. Активирование и отравление катодов. Стабильность эмиссии и срок службы.

Плазменные источники электронов.

Движение заряженных частиц в вакууме в электрических и магнитных полях.

Электродинамика. Уравнение Максвелла – обобщение опытных факторов. Основные характеристики электромагнитного поля и среды.

Волноведущие системы и резонаторы в электронных приборах. Их основные свойства.

Замедляющие системы в электронных приборах (спираль, гребенка. цепочка связанных резонаторов). Сопротивление связи. Дисперсионная характеристика. Полосы прозрачности и непрозрачности.

# Электронные приборы и устройства, основанные на движении заряженных частиц в вакууме и газах

Электровакуумные приборы (ЭВП). Приборы с электростатическим управлением. Плоский диод. Триоды, тетроды, пентоды. Частотные ограничения.

Основные свойства и характеристики приборов с электростатическим управлением.

Плазменные приборы (ПЛП). Принцип действия, конструкция и характеристики плазменных приборов.

Устройства формирования и фокусировки интенсивных электронных потоков. Общие принципы формирования интенсивных электронных потоков. Электронно-оптические системы (ЭОС) СВЧ приборов О- и М-типа.

Магнитные электрические фокусирующие И Магнитная системы.  $(M\Pi\Phi C)$ . фокусирующая система реверсивная периодическая Магнитная фокусировка (МРФ). Периодическая электростатическая фокусировка (ПЭФ). Коллекторы. рекуперацией. Автоматизированные Коллекторы c методы проектирования ЭОС.

Электронно-лучевые трубки (ЭЛТ) и фотоэлектрические приборы. Конструкция и характеристики электронно-лучевых приборов. Фокусирующие и отклоняющие системы ЭЛТ. Катодолюминесценция. Осциллографические трубки. Черно-белые и цветные кинескопы. Передающие трубки. Электронно-оптические преобразователи. Основные типы фотоэлементов.

Сверхвысокочастотные (СВЧ) электронные приборы. Методы анализа явлений в СВЧ приборах.

Исходные уравнения поля и уравнения движения. Наведенный ток, емкостный ток. Конвекционный ток. Взаимодействие потока электронов с полем бегущей волны

Группировка электронов. Метод заданного поля и метод заданного тока. Самосогласованные решения.

Конструкции и параметры СВЧ ЭВП. Основные типы СВЧ приборов, принцип действия. Конструктивные особенности и характеристики приборов О-типа (лампы с бегущей волной, лампы с обратной волной (ЛОВ), клистроны) и приборов М-типа (магнетроны, амплитроны, ЛОВ). Автоматизированное проектирование клистронов, ЛБВ, ЛОВ, магнетронов, амплитронов.

Шумы в электронных приборах. Тепловые явления в электронных приборах. Основные источники тепла. Свободная и принудительная конвекция. Теплопередача теплопроводностью. Стационарный тепловой режим деталей электронных приборов. Методы автоматизированного проектирования устройств охлаждения в электронных приборах.

### Материалы узлов и устройств вакуумных и плазменных приборов

Тугоплавкие металлы. Вольфрам, молибден, тантал, и др. материалы и их сплавы. Применение тугоплавких металлов в вакуумной и плазменной электронике.

Благородные металлы. Платина, палладий, родий, осмий, золото, серебро и их сплавы. Применение благородных металлов и их сплавов для защиты деталей вакуумных и плазменных приборов.

Черные и цветные металлы. Никель, железо, медь, Сплавы и композиции черных и цветных металлов. Методы очистки и получения. Вакуумная плавка. Применение для изготовления деталей.

Железоникелевокобальтовые, железоникелевохромистые и феррохромовые сплавы. Применение их для сплавов с диэлектриками.

Щелочные, щелочноземельные металлы. Окиси щелочноземельных металлов. Применение для вакуумных и плазменных приборов и для электрофизических насосов.

Припои. Низко- и высокотемпературные припои. Требования к припоям.

Магнитные материалы. Магнитомягкие материалы. Ферриты. Кристаллические ферромагнетики.

Стекло. Состав, оборудование и производство стекла. Физико-химические свойства. Термическое расширение. Термостойкость, электропроводность. Диэлектрические потери. Химическая устойчивость. Проницаемость для радиационных излучений. Газопроницаемость. Выбор стекла для различных условий применения. Обработка стекла. Ситаллы. Спаи стекла с металлами. Приборы для контроля качества спаев.

Керамика. Виды керамики, используемой в вакуумной и плазменной электронике. Физико-химические свойства керамики, Механические свойства. Термическое расширение. Теплопроводность. Удельное электрическое, объемное и поверхностное сопротивление. Диэлектрические свойства. Оптические свойства. Газопроницаемость. Спаи керамики с металлами.

### Вспомогательные материалы

Люминофоры. Применение люминофоров для электронно-лучевых приборов, люминесцирующих экранов и источников света.

Эластомеры. Применение эластомеров для герметизации вводов ЭВП и ПЛП.

Газы. Инертные газы. Получение и физические свойства газов. Применение инертных газов в технологии ЭВП и ПЛП. Методы очистки инертных газов.

Активные газы. Водород, азот, кислород и углекислый газ. Физические и химические свойства активных газов. Методы очистки и приборы для контроля чистоты газов.

#### Технология вакуумных и плазменных приборов и специальное оборудование

Изготовление металлических деталей ЭВП и ПЛП. Изготовление деталей из прутков. Холодная штамповка, обточка, фрезерование, И выдавливание. Смазки, применяемые при изготовлении деталей, Оборудование, приборы и инструмент, используемые при изготовлении деталей ЭВП. Способы и оборудование для обработки поверхности деталей. Травление, пескоструйная полировка, карбонизация, голтовка, осаждение покрытий электролитов и из газовой среды. Электрофизические и электрохимические методы материалов. Области применения эффективность И Электрохимическая и анодно-механическая обработки.

Очистка деталей ЭВП и ПЛП. Виды загрязнений деталей ЭВП и ПЛП. Загрязнение деталей механическими частицами и методы борьбы с ними. Оборудование для очистки воздуха от аэрозолей. Приборы для контроля чистоты воздуха. Загрязнения деталей органическими и неорганическими веществами. Механизм влияния загрязнений на работоспособность ЭВП и ПЛП.

Интенсификация очистки ультразвуком. Очистка стекла и керамики. Оборудование и материалы, используемые для очистки деталей. Контроль солевых и органических загрязнений. Приборы для контроля.

Термические методы очистки деталей. Отжиг в вакууме, в восстановительных и инертных средах. Основные закономерности термического обезгаживания деталей. Влияние на очистку температуры, давления и чистоты газов. Оборудование для отжига деталей. Хранение очищенных деталей. Тара для хранения очищенных деталей.

Изготовление катодов и подогревателей. Способы и оборудование для нанесения эмиссионных и изоляционных паст на катоды и подогреватели. Контроль качества катодов и подогревателей. Измерение температуры и эмиссионных характеристик катодов.

Теплофизические явления в катодах. Методы и оборудование для изготовления газопоглотителей.

Методы соединения деталей. Контактная сварка. Аргонодуговая сварка. Электронно-лучевая сварка. Сварка с использованием лазеров. Термокомпрессионная сварка. Оборудование, используемое для различного вида сварок. Пайка деталей припоями. Многоступенчатая пайка. Пайка в вакууме, в защитных и восстановительных средах. Концентраторная пайка. Оборудование для пайки. Печи периодического и непрерывного действия. Критерии паяемости и свариваемости деталей. Методы и приборы для контроля герметичности сварных и паяльных швов.

Заварка приборов со стеклянной оболочкой. Оборудование для заварки. Методы и приборы для контроля качества заварки.

Откачка ЭВП и ПЛП. Газы, выделяемые из деталей в процессе откачки. Способы и режим обработки катодов и оболочек приборов. Контроль процесса откачки. Особенности откачки приборов в молекулярном режиме. Откачное оборудование. Автоматы и откачные посты. Программирование и автоматизация процесса откачки. Обслуживание откачного оборудования. Способы очистки вакуумных систем. Вредные последствия длительного и высокотемпературного обезгаживания ЭВП при очистке. Особенности откачки ПЛП и способы наполнения их газами.

Методы получения вакуума при помощи геттеров. Типы распыляемых и нераспыляемых геттеров. Сорбционные свойства геттеров. Расположение геттеров в приборах. Влияние типа геттеров на параметры приборов. Способы активировки геттеров при откачке.

Тренировка ЭВП и ПЛП. Цель тренировки. Импульсные и статические режимы тренировок.

Тренировки высоковольтных приборов. Оборудование для тренировки приборов.

Испытание ЭВП и ПЛП. Измерение параметров ЭВП и ПЛП. Механические испытания. Климатические испытания. Испытания на долговечность. Оборудование, применяемое для измерения электрических параметров ЭВП и ПЛП и испытания их на устойчивость к механическим и климатическим воздействиям.

# 3. Примерный перечень вопросов для подготовки к собеседованию по предполагаемой теме диссертационного исследования (3-й вопрос билета)

- 1. Обоснуйте выбор темы исследования.
- 2. Обоснуйте актуальность, научную новизну исследования.
- 3. Очертите область исследования, объект и предмет исследования.
- 4. Каковы основные цели и задачи исследования.
- 5. Обоснуйте, решались ли выбранные задачи ранее. Если решались, то, кем или какими научными школами, какие результаты были получены. Почему вы считаете, что остались «белые пятна» и именно Вы знаете, как их устранить.
- 6. Изложите собственное видение рассматриваемой проблемы и пути решения задачи (при этом отразите методологическую основу будущего исследования какие конкретные методы и инструментальные средства из научного арсенала предполагается использовать при решении задачи).
- 7. Оцените состояние работы на сегодняшний день (уровень задела).
- 8. Обозначьте ожидаемые результаты исследования, их потенциальную востребованность и экономическую эффективность в случае практического использования.

### 4. Оценка уровня знаний (баллы)

Итоговая оценка выставляется по пятибалльной шкале. Поступающие, получившие менее 4 баллов, к последующим вступительным испытаниям и участию в конкурсе не допускаются.

Критерии оценивания	Баллы, оценка
Ответы на поставленные вопросы полные и исчерпывающие, без замечаний; продемонстрировано глубокое знание теоретической части курса	5 (отлично)
Ответы полные, с незначительными ошибками, указывающие на наличие несистематичности либо пробелы в знаниях; если поступающий допускает неточности, то при помощи вспомогательных вопросов экзаменатора исправляет свои ошибки	4 (хорошо)
Ответы не полные, со значительными замечаниями, допущены существенные ошибки при ответе на вопросы членов экзаменационной комиссии	3 (удовлетворительно)
Поступающий показал существенные пробелы в знаниях основных положений теории, не ответил на ряд вопросов членов экзаменационной комиссии	2 (неудовлетворительно)

#### Библиографический список

- 1. Сушков, А. Д. Вакуумная электроника. Физико-технические основы: учебное пособие / А. Д. Сушков. Санкт-Петербург: Лань, 2021. 464 с.
- 2. Аксенов А.И., Злобина А.Ф., Панковец Н.Г., Носков Д.А. Вакуумные и плазменные приборы и устройства. Учебное пособие. ТУСУР, Томск, 2007.
- 3. Агапов, В.М. Аникин, Ю.В. Анисимов и др. Под ред. Лебедева И.В. Генераторы и усилители СВЧ. М.: Радиотехника. 2007. 352 с.
- 4. Царев В.А., Спиридонов Р.В. Магнитные фокусирующие системы электровакуумных микроволновых приборов О-типа. Учебное пособие. Саратов: изд-во «Новый ветер», 2010. 352 с.
- 5. Сушков А.Д. Вакуумная электроника. Физико-технические основы. СПб: Лань, 2008. 356 с.
- 6. Приборы физической электроники: учебное пособие/А.И. Астайкин [и др.]; под ред. А.И. Астайкина. М.: Высшая школа, 2008. 229 с.
- 7. Ворончев Т.А., Соболев В.Д. Физические основы электровакуумной техники. М., Высшая школа, 1967.
- 8. Кудинцева Г.А. и др. Термоэлектронные катоды. М., Энергия, 1966.
- 9. Лебедев И.В. Техника и приборы СВЧ. Изд. 2-е. М., Высшая школа. Т.1, 1970, Т. 2, 1972.
- 10. Эспе В. Технология электровакуумных материалов. М., Госэнергоиздат. Т.1, 1962, М., Энергия, Т.2, 1968, Т.3, 1969.
- 11. Черепнин Н.В. Вакуумные свойства материалов для электронных приборов. М., Сов. радио, 1966.
- 12. Батыгин В.Н. и др. Вакуумно-плотная керамика и ее спаи с металлами. М., Энергия, 1973.
- 13. Черепнин Н.В. Основы очистки, обезгаживания и откачки в вакуумной технике. М., Сов. радио, 1967.
- 14. Александрова А.Т. Оборудование электровакуумного производства. М., Энергия, 1974.
- 15. Жигарев А.А., Шамаева Г.Г. Электронно-лучевые и фотоэлектронные приборы. М., Высшая школа, 1982.

Программа одобрена на секция НТС) АО «НПП «Исток»2022 г.)	заседании научно-экспертного им. Шокина» (протокол №	,
Председатель НЭС, д.фм.н., с.н.с.		А.И. Панас